



MEF 2021 出展社・スポンサーハイライト Part III

開催迫る MEF2021 バーチャル展示オープン バーチャルブースツアー、セットアップ完了

MEMS Engineer Forum 2021 (MEF2021)のバーチャル展示場が、開催に先駆けてオープンしました。ぜひご高覧をお願いいたします。

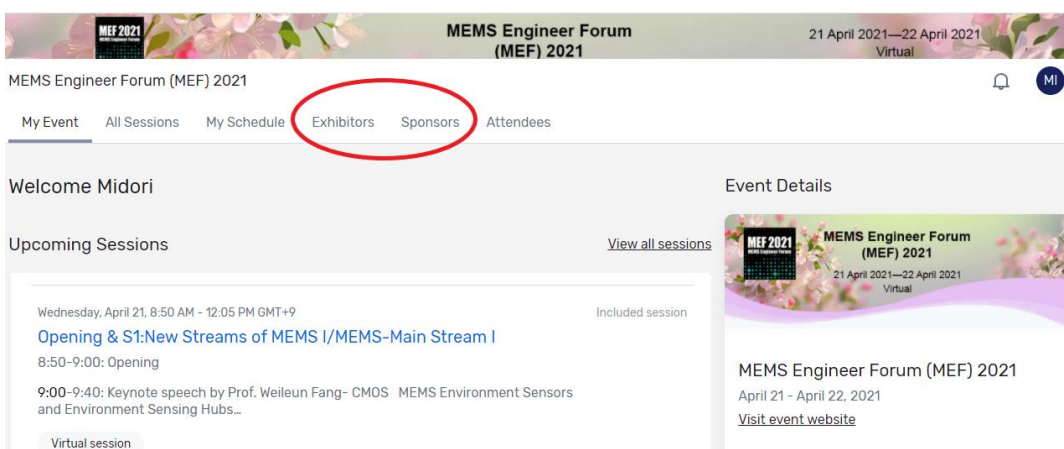
すでにご登録済みの方は、下記にアクセスしてください。アクセス直後に通知される認証コードが必要です。

<https://cvent.me/0KRR2B>

これから参加登録をされる方は下記にアクセスし、ご登録をお願いします。

<https://cvent.me/zPkk8w>

固有のマイページに入られましたら、上部タブの Exhibitors/Sponsors をクリック頂きますと、各社情報が開きます。ここから、個別メッセージやオンライン会議の予約などが可能となります。



バーチャルツアーのアウトラインも出来上がりました。MEF2021 開催日両日とも、午後1時にスタートいたします。All Sessions タブをクリックし、Virtual Exhibit Booth Tour にお入り下さい。ツアーリーダーが率いるチームごとに、訪問先ブースが表示されています。1グループにつき、3～4社を訪問いたします。

初日 21 日のバーチャルツアー表示内容：

1:00 pm-1:35 pm JT

Virtual Exhibit Booth Tour

Selected

Break/Exhibit Hour & Virtual Exhibit Booth Tour

Group A

Coventor, A Lam Research Company/SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD./MIRISE Technologies Corp.

Group B

TDC Corp./ROHM Co., Ltd./SAKAGUCHI E.H VOC CORP./Xperi

Group C

Polytec Japan/4-University Nano/Micro Fabrication Consortium/Kojundo Chemical Lab. Co., Ltd./Heidelberg Instruments KK

Group D

SPP Technologies Co., Ltd./The University of Tokyo - Miyake Lab/DogNose Sensor Lab.

Group E

SUSS MicroTec KK/Kanematsu PWS LTD./Oga, Inc./Tohoku Univ. Micro System Integration Center /MEMS Park Consortium

Group F

Touchence Inc./Kyodo International, Inc./SilTerra Malaysia Sdn. Bhd./FURUYA METAL CO., LTD.

Virtual Exhibit Booth Tour

Wednesday, April 21, 1:00 PM-1:35 PM GMT+9

Group A

Coventor, A Lam Research Company/SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD./MIRISE Technologies Corp.

Group B

TDC Corp./ROHM Co., Ltd./SAKAGUCHI E.H VOC CORP./Xperi

Group C

Polytec Japan/4-University Nano/Micro Fabrication Consortium/Kojundo Chemical Lab. Co., Ltd./Heidelberg Instruments KK

Group D

SPP Technologies Co., Ltd./The University of Tokyo - Miyake Lab/DogNose Sensor Lab.

Group E

SUSS MicroTec KK/Kanematsu PWS LTD./Oga, Inc./Tohoku Univ. Micro System Integration Center /MEMS Park Consortium

Group F

Touchence Inc./Kyodo International, Inc./SilTerra Malaysia Sdn. Bhd./FURUYA METAL CO., LTD.

翌 22 日にも同時刻にブースツアーが企画されています。ツアーリーダーの訪問先はシャッフルされていますので、事前にご確認の上、奮ってご参加ください。

●出展社・スポンサーハイライト Part III

各社の概要ならびにハイライトを公開して参ります。数字は掲載順の通し番号となります。

出展社ハイライト 3：ティ・ディ・シー

ティ・ディ・シーは、さまざまな材質への精密な機械加工を実現してきました。得意とする研磨技術にて、面粗粗さ・寸法・平面度・平行度などは、ナノレベルの精度を保証。各種高精度部品を数量1個から量産まで柔軟に対応しています。

MEMS 分野における課題解決として、接合用基板の表面粗さ向上 (Ra1nm 以下) や清浄化、接合ウエーハに対する薄化加工や TTV 向上、微細加工基板の裏面研磨による厚み管理などが可能。さらに、CMP 技術を用い、さまざまな材質への研磨や面粗さ向上、薄化技術、清浄化技術を提供しています。AFM や膜厚測定器を活用し、精密計測と精密加工の信頼性向上への研鑽も重ねています。

出展社ハイライト 4：ハイデルベルグ・インストルメンツ

ハイデルベルグ・インストルメンツは、レーザー直接描画装置やマスク描画装置の開発と製造を行う独ハイデルベルグ・インストルメンツ・マイクロテック社の日本法人です。MEMS 用途には、フォトリソグラフィ向けレーザー直接描画装置、マスクレス露光装置およびサーマルプローブ式描画装置の販売および技術サービスを提供しています。

今回は、最新レーザー直接描画ソリューション NanoFrazor の紹介と最新グレイスケール露光の実践内容を出展・説明します。最小描画サイズ 15nm 未満、最大 4,000 階調のグレイスケールパターン、4 インチウエハ 1 枚 2 分の高速マスクレス露光など、革新的な内容にご期待ください。

出展社ハイライト 5：ミライズテクノロジーズ

ミライズテクノロジーズは、デンソーとトヨタ自動車の半導体技術を結集し、2020 年に設立した新企業です。未来のモビリティ社会の実現に貢献するため、クルマ視点とシステム、部品視点を融合し、CASE 用の半導体をスピーディに開発します。革新的な MEMS デバイスの研究、先行開発を一緒に取り組むパートナーを募集しています。

編集：稲子みどり (MEF 委員)

参加登録は [こちらから](#) プログラムスケジュールは [こちらから](#) お問い合わせ：mef_2021@semiconportal.com



MEF 2021 Exhibitor/Sponsor Highlight Part III

The event is approaching! MEF2021 virtual exhibition open
Virtual booth tour, setup completed

The virtual exhibition hall of the MEMS Engineer Forum 2021 (MEF 2021) has opened prior to the event. Please take a look now!

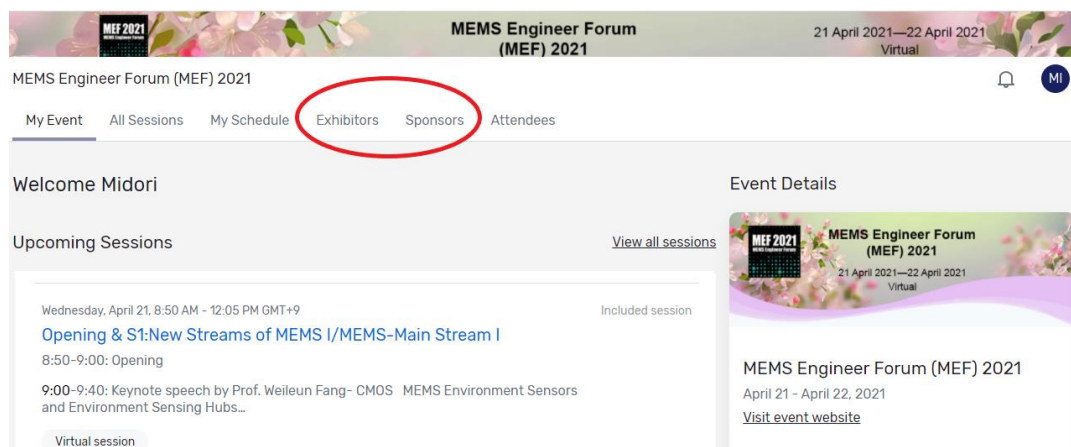
If you have already registered, please access the following. You will need an authorization code that will be sent to you immediately after access.

<https://cvent.me/0KRR2B>

If you are going to register for participation since now, please access the following and register.

<https://cvent.me/zPkx8w>

When you enter to the unique "My Page", click Exhibitors / Sponsors on the top tab to open the company information. From the function on the page, you can send individual messages and book online meetings.



The outline of the virtual tour is also completed. It will start at 1:00 pm on both days. Click on the "All Sessions" tab to enter the "Virtual Exhibit Booth Tour". Each booth is grouped as each team led by the tour leaders. One team will visit 3-4 exhibition companies.

Virtual tour contents on the 21st of the first day :

1:00 pm-1:35 pm JT

Virtual Exhibit Booth Tour

Selected

Break/Exhibit Hour & Virtual Exhibit Booth Tour

Group A

Coventor, A Lam Research Company/SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD./MIRISE Technologies Corp.

Group B

TDC Corp./ROHM Co., Ltd./SAKAGUCHI E.H VOC CORP./Xperi

Group C

Polytec Japan/4-University Nano/Micro Fabrication Consortium/Kojundo Chemical Lab. Co., Ltd./Heidelberg Instruments KK

Group D

SPP Technologies Co., Ltd./The University of Tokyo - Miyake Lab/DogNose Sensor Lab.

Group E

SUSS MicroTec KK/Kanematsu PWS LTD./Oga, Inc./Tohoku Univ. Micro System Integration Center /MEMS Park Consortium

Group F

Touchence Inc./Kyodo International, Inc./SilTerra Malaysia Sdn. Bhd./FURUYA METAL CO., LTD.

Virtual Exhibit Booth Tour

Wednesday, April 21, 1:00 PM-1:35 PM GMT+9

Group A

Coventor, A Lam Research Company/SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD./MIRISE Technologies Corp.

Group B

TDC Corp./ROHM Co., Ltd./SAKAGUCHI E.H VOC CORP./Xperi

Group C

Polytec Japan/4-University Nano/Micro Fabrication Consortium/Kojundo Chemical Lab. Co., Ltd./Heidelberg Instruments KK

Group D

SPP Technologies Co., Ltd./The University of Tokyo - Miyake Lab/DogNose Sensor Lab.

Group E

SUSS MicroTec KK/Kanematsu PWS LTD./Oga, Inc./Tohoku Univ. Micro System Integration Center /MEMS Park Consortium

Group F

Touchence Inc./Kyodo International, Inc./SilTerra Malaysia Sdn. Bhd./FURUYA METAL CO., LTD.

The next day, the 22nd, another booth tour is planned at the same time slot. The destinations of the tour leaders are shuffled, so please check in advance and join.

●Exhibitor/Sponsor Highlight Part III

It will be published the outline and highlights of each company. The numbers are serial numbers in the order of publication.

Exhibitor Highlight 3 : TDC

TDC has achieved precision machining into a variety of materials. With the specialty polishing technology, TDC guarantees nano-level accuracy in surface roughness, dimensions, flatness, parallelism, etc. They flexibly handle various high-precision parts from a single quantity to mass production.

As a solution to problems in the MEMS field, it is possible to improve the surface roughness (Ra1 nm or less) and cleanliness of the bonding substrate, thin the bonded wafer, improve the TTV, and control the thickness by polishing the back surface of microprocessed substrate. Furthermore, using CMP technology, they provide polishing to various materials, surface roughness improvement, thinning technology, and cleaning technology. Utilizing AFM and film thickness measuring instruments, TDC is also studying to improve the reliability of precision measurement and precision machining.

Exhibitor Highlight 4 : Heidelberg Instruments

Heidelberg Instruments is a Japanese corporation of Heidelberg Instruments Microtechnique in Germany, which develops and manufactures laser direct drawing devices and mask drawing devices. For MEMS applications, they sell and provide technical services for laser direct drawing equipment, maskless exposure equipment and thermal probe type drawing equipment for photolithography.

This time, we will introduce the latest laser direct drawing solution NanoFrazor and exhibit and explain the practical contents of the latest grayscale exposure. Expect their innovation such as a minimum drawing size of below 15 nm, a grayscale pattern of up to 4,000 gradations, and high-speed maskless exposure for 2 minutes per 4-inch wafer.

Exhibitor Highlight 5 : MIRISE Technologies

MIRISE Technologies is a new company established in 2020 by combining the semiconductor technologies of Denso and Toyota Motor Corporation. In order to contribute to the realization of the future mobility society, MIRISE will speedily develop semiconductors for CASE by fusing the viewpoints of cars, systems, and parts. They are looking for partners to work together on research and advanced development of innovative MEMS devices.

Join MIRISE team!

Editor: Midori Inako

[Click here](#) for online registration [Program Schedule](#) Contact: mef_2021@semiconportal.com